



深圳长城开发科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要

2019年04月

证券代码:000021

证券简称:深科技

公告编号:2019-014

深圳长城开发科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
谢韩珠	独立董事	个人原因	邱大梁

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 1,471,259,363 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深科技	股票代码	000021
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李丽杰	唐磊	
办公地址	深圳市福田区彩田路 7006 号	深圳市福田区彩田路 7006 号	
传真	0755-83275075	0755-83275075	
电话	0755-83200095	0755-83200095	
电子信箱	stock@kaifa.cn	stock@kaifa.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司属于电子信息制造服务（EMS）行业，为客户提供优质的电子产品研发制造服务，随着制造技术与信息技术不断融合，信息技术逐渐在各类终端中应用，产业边界逐渐模糊，呈现出多元化的发展趋势，将不断调整产品结构，垂直整合，延长产业链，并向战略新兴产业布局。

公司业务主要涵盖计算机存储、半导体存储、通讯及消费电子、医疗设备等各类高端电子产品的先进制造服务以及集成电路半导体封装与测试、计量系统、自动化设备及相关业务的研发生产，公司也在积极布局新能源汽车电子等战略性新兴产业。

公司连续多年在 MMI 全球 EMS 行业排名前列，是中国企业 500 强以及深圳工业百强企业。公司在美国、日本、英国、荷兰、印度、新加坡、马来西亚等十多个国家或地区设有分支机构或拥有研发团队，建立了集合技术研发、工艺设计、生产控制、采购管理、物流支持等不同服务模块的完整电子产品制造服务链，为全球客户提供高端电子产品研发及制造服务。目前，公司已完成包括深圳、苏州、东莞、惠州、成都等研发制造基地以及马来西亚、菲律宾等海外工厂的建立布局。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	16,061,005,965.27	14,209,778,550.46	13.03%	15,069,170,534.44
归属于上市公司股东的净利润	530,073,217.29	541,303,018.08	-2.07%	214,423,542.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,409,211.42	79,051,144.32	-177.68%	96,116,132.58
经营活动产生的现金流量净额	420,770,432.04	719,672,524.36	-41.53%	356,539,062.13
基本每股收益（元/股）	0.3603	0.3679	-2.07%	0.1457
稀释每股收益（元/股）	0.3603	0.3679	-2.07%	0.1457
加权平均净资产收益率	8.67%	9.74%	-1.07%	4.07%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	15,539,378,939.58	16,599,483,730.27	-6.39%	11,717,371,549.69
归属于上市公司股东的净资产	6,285,956,609.93	5,856,692,553.42	7.33%	5,258,554,028.27

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,003,078,929.95	4,261,912,805.11	4,346,119,773.92	3,449,894,456.29
归属于上市公司股东的净利润	85,431,303.95	86,346,908.85	269,057,362.30	89,237,642.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,170,155.39	21,335,000.83	-577,974.74	-85,336,392.90
经营活动产生的现金流量净额	43,924,926.66	96,435,648.62	488,823,486.88	-208,413,630.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况**(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表**

单位：股

报告期末普通股股东总数	104,129	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	110,504	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	44.51%	654,839,851				
博旭（香港）有限公司	境外法人	7.25%	106,649,381				

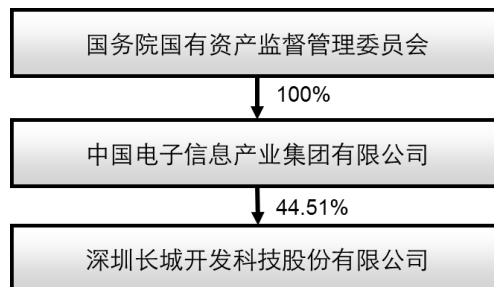
柴长茂	境内自然人	1.22%	17,909,900			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	16,407,043			
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	7,863,764			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	3,993,100			
中信银行股份有限公司—建信中证500 指数增强型证券投资基金	其他	0.26%	3,790,596			
周淑芳	境内自然人	0.20%	3,008,600			
彭伟燕	境内自然人	0.19%	2,758,175			
龙力控股有限公司	境外法人	0.18%	2,598,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 17,909,900 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年度全球经济环境错综复杂，新兴经济体经济复苏遭遇挑战，地区间贸易摩擦加剧，全球经济遇到的风险和困难逐步增多。

面对复杂的国内外局势，公司始终坚持稳中求进的发展思路，大力开拓国内外市场，稳步推进产业结构调整。作为全球领先的电子产品制造服务（EMS）专业提供商，深科技在现有EMS核心业务基础上，积极寻求新兴产业成长机会，加大力度布局集成电路半导体封装与测试和新能源汽车电子等战略性新兴产业。一方面通过推进智能制造持续优化先进制造管理体系，夯实公司EMS核心能力，并在保持现有计算机与存储及其相关产业制造服务优势的同时，着力提高管理和运营效率，提升企业发展质量和效益，另一方面通过自主创新与投资并购等方式，促进产业结构调整，实现经营业务的稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入160.61亿元，同比增长13.03%；实现归属于上市公司股东的净利润5.30亿元，同比下降2.07%。

1) 集成电路相关产品

我国集成电路产业在消费电子和计算机等传统应用领域需求持续增长，在云计算、物联网、大数据等战略性新兴产业快速发展的拉动下，市场需求持续发力。公司作为目前国内唯一具有从集成电路高端DRAM/Flash 晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业，紧紧围绕集团布局，以国家集成电路产业发展为契机，把握发展机遇发挥现有优势，持续发展先进封装测试技术，积极参与委外封装测试项目，力求在新一轮产业变革中构筑先发优势。

报告期内，公司在东莞产业基地独资设立沛顿东莞子公司，用于发展高性能存储芯片及满足未来新增产能持续扩张及存储芯片封测新技术发展的需求。目前公司芯片封测产品主要包括 DDR3、DDR4 内存颗粒，eMCP、USB、SSD 闪存芯片以及 Fingerprint 指纹芯片等，并具备 wBGA、FBGA、eMCP、POP、LGA、TSOP 等封测技术。未来随着公司进一步加大技术创新力度，公司的技术竞争优势将不断提升。公司于报告期内新建成 QFN、SOP 等产品线。为把握国内外存储芯片发展机遇，满足市场对高速、低功耗、大容量记忆芯片封装需求，公司已着手推动 DDR5、GDDR5 等新产品的应用，并在此基础上发展晶圆级封装、系统级封装及硅穿孔等先进封装技术，不断增强公司的核心竞争力，实现公司的可持续发展。

目前，公司为全球最大的内存模组生产基地之一，与业内国际化大客户形成战略合作伙伴关系，能够根据客户的芯片和应用要求，设计定制化的专用产品。产品主要应用于计算机、网络通讯消费电子及智能移动终端、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能领域。

报告期内，随着 LED 芯片制造行业景气度的持续提升，公司继续扩大为 LED 芯片厂商提供点测分选的生产能力，产品广泛应用于通用照明、液晶面板背光光源、小间距 LED 显示屏等领域。同时，随着液晶面

板背光及智能穿戴技术发展迅速，公司提前布局，已对 Mini-LED 倒装芯片的测试封装技术开展研发工作，并在背光源模组制造方面储备了一定的技术基础，有望为公司带来新的利润增长点。报告期内，公司与移动终端指纹识别芯片封测方面的客户合作稳定，但因人脸识别技术等更迭速度加快，该业务发展受到一定影响。

在存储产品领域，目前产品主要包括内存模组、USB 存储盘（U 盘）、Flash 存储卡、SSD 等存储产品，公司采用行业领先的生产制造工艺，为客户提供包括 SMT 制造、测试、组装、包装及全球分销服务，提供存储集成电路设计、制造、封测的配套业务。

报告期内，随着全球晶圆供货的逐步回暖，公司集成电路行业相关产品业务收入有所增长。

2) 自主研发产品

公司自主研发产品主要包括计量系统产品、自动化设备产品、工业物联网产品等业务。

在计量系统业务领域，公司主营智能水、电、气等能源计量管理系统的全套解决方案及配套产品和服务，拥有 20 多年研发、营销及先进制造的丰富经验，业务已遍布欧洲、南美、亚洲、非洲等地，经过多年的发展，公司已在英国、荷兰、韩国、泰国、成都、香港等地设立了分支机构，与多个地区国家级能源事业单位客户建立了合作关系。报告期内，公司业务经营持续稳定，主营业务收入同比增长 20.33%。在技术积累储备方面，公司推出 NB IoT（窄带物联网）应用模组，该产品主要应用于电、水、气、热表的物联网改造，已在意大利完成 NB-IoT 水表项目试点；与知名通讯运营商进行水表、电表的物联网联网测试，获得市场高度认可；全系列的电力载波方案产品成功获得 G3-PLC 认证；与全球顶尖的云服务商合作，为电力客户提供计量系统云服务，实现云计算、大数据、智能化三者相结合的整体解决方案，并已批量部署；公司从智能电表产品到为客户提供的管理信息系统均达到了银行级的安全加密水平，实现了 DLMS Suite1/2，公司计量业务的信息安全管理水平已达到业界顶尖水准。在市场拓展方面，顺利通过德国及英国的全套产品认证测试，为进一步开拓市场奠定了坚实基础；在瑞典市场为客户提供国际一流的 RF Mesh（无线自组网）网络方案，赢得瑞典第二代智能电表项目中最大的业务合同。公司积极参与国际电能表技术交流，共同参与国际电表行业标准的制定。未来公司将继续提高技术研发实力，为市场提供更专业、更经济的智能用电产品及系统解决方案。

在自动化设备领域，在满足公司内部需求的同时，积极开拓外部市场，不断加强在自动化产品领域的技术创新和资源整合，为客户提供智能高效的自动化生产线及自动化解决方案，已形成高精密自动装配、自动点胶、自动贴标、自动化线体以及非标自动化五个产品系列。报告期内，光学字符识别自动化研究、3G 硬盘 PCBA SMT 后段自动化生产线等新技术项目成功立项，未来公司将运用全面管理体系集成供应商数据，实现互联互通智能应用，打造出一整套自我完善的数字化智慧工厂管理系统。

在工业物联网领域，公司设有专业团队专注于物联网产品的研发和应用，现拥有实时静电防护监控系统（KEDAS）、工业物联网系统（iDAS）智能工地管理系统（iFOS）、智能离子风机等多项自主研发的工业物联网专利和产品。公司在已有技术基础上，重点研制开发工业物联网核心软硬件产品及平台技术，目前已成功开发出工业物联网云平台，并通过物联网在管理和生产中的应用，进一步提高了各类智能产品的质

量和可靠性，生产管理效率不断提高。报告期内，工地管理系统（iFOS）亮相高交会并获得广泛关注，该系统作为实现建筑工地管理系统化、智能化、高效化的解决方案，只需通过佩戴智能头盔便可实现人员定位、安全监控、危险区域提示、主动紧急呼叫、辅助考勤等功能。系统不仅可应用于建筑施工现场，也可配备于造船、电力、燃气、采矿等特殊高危行业户外施工作业中，非常看好市场前景。未来公司计划将物联网技术逐步由生产制造向对客户服务推进，为客户提供相应的管理运营能力和服务，成为产品价值链中的更重要的一环。

3) 硬盘相关产品

公司硬盘相关产品包括硬盘磁头、硬盘电路板和盘基片。

个人电脑需求逐年下滑，固态硬盘市场份额的持续扩大致使传统硬盘市场出货量继续萎缩，受其影响，公司的硬盘磁头及相关产品业务均有不同程度的下降。但在数据安全和容量需求领域，全球“云计算”大量的数据快速增长，带动不同规模数据中心的迅速扩张，因此也带动了一定的传统硬盘需求，与其相关的硬盘盘基片业务因市场生产厂商日少，报告期内市场需求强劲，客户呈增加趋势，但 2019 年该业务已现趋缓。此外，为降低外部环境对公司业务带来的冲击，公司积极采取应对措施，一方面调整产品结构，持续加强工艺的改进与研发，引入存储服务器、固态硬盘等新业务的生产，延伸业务产业链，另一方面公司通过内部管理提升，实施精益生产以及进一步提升全产线自动化率等措施，降本增效，保持该业务的盈利能力。

4) 电子产品制造服务

电子产品制造业务是指公司为客户提供物料采购、SMT贴片、整机组装、测试、物流配送等环节的电子产品制造服务，主要包括通讯与消费电子、医疗产品、商业与工业等业务。

在通讯与消费电子领域，全球智能手机市场销售连续五个季度下滑，国产智能手机出货量亦有一定幅度的下降。手机通讯业务由于人工成本和费用增长以及订单不稳定等因素影响，2018年全年出现大幅亏损，并由此导致公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润出现亏损。为促进通讯业务的可持续健康发展，提高产品综合竞争力，公司在桂林设立全资子公司，充分利用当地的人力成本、物流等优势及政策支持，提升盈利能力。根据项目规划，桂林子公司将打造成为智能手机制造服务基地，全部建成后所形成产能可为公司带来更多的增量业务。2019年度随着客户市场占有率的不断提升，公司手机业务订单量亦有望大幅增长。目前公司已开始导入通信基站板卡业务，并有望成为公司新的利润增长点。

在医疗产品业务领域，公司拥有通过广东省医疗器械质量监督检验所检测的无菌净化生产车间，具备医疗产品联合设计和制造能力，目前产品包括呼吸机、腹膜透析加温仪、智能血糖仪等。报告期内，公司深圳工厂和苏州工厂都顺利获得国家食品药品监督管理总局（CFDA）颁发的产品许可证及生产许可证，同时，为进一步提升在医疗产品领域的技术实力及生产能力，公司在计划、物流、制造、检测等多领域导入智能系统，以交付更有效更安全的产品。未来公司将不断扩大医疗器械研发团队，通过ODM和JDM等模式提升竞争力，并在此基础上加大“家用医疗产品”、“便携式医疗器械”及“慢病管理类医疗器械”的研发投入，持续对现有产品进行升级，以提升公司在该领域内的市场份额和行业影响力。

在其他电子产品方面，报告期内，公司智能运通事业部的机器人业务顺利完成试产并获得客户优必选高度认可，双方签署战略合作协议，为进一步深化合作打下坚实基础。消费级无人机业务开展顺利，并利用现有客户优势积极跟进和导入工业级无人机等产品；汽车电子业务开拓成果显著，智能传感器业务实现小量生产。公司凭借多年电子行业制造经验，有望与行业知名客户开展进一步深入合作，为未来发展打开业务成长空间。

5) 新能源业务

在动力电池领域，动力电池包是新能源汽车核心能量源，为整车提供驱动电能，随着新能源汽车需求量的不断提高，动力电池需求也节节攀升，公司成功开拓新能源汽车动力电池包业务，与全球知名的汽车动力电池系统企业建立合作关系，目前已有数款产品进入试产阶段，未来有望在新能源汽车电子方面通过发挥产业链优势，共同做大做强新能源汽车业务。

在超级电容领域，公司拥有多种超级电容整套模组制造解决方案，与国际顶级超级电容厂商形成长期稳定的合作关系，目前主要客户为MAXWELL和TECATE。为更好的完善供应链，报告期内已导入两条单体制造生产线。公司未来将积极布局超级电容相关技术工艺的提升和产业化，为公司在该领域的快速发展奠定基础。

在LED领域，开发晶作为LED行业的龙头企业之一，也是公司在LED产业链的核心平台。2017年底为进一步做大做强LED产业，开发晶引进无锡国联系增资扩股，目前业务范围涵盖LED外延片、芯片、封装模组、照明应用、汽车照明、小间距显示器件等全产业链环节，具有上下游协同开发、快速响应、整体供应链成本低的优势。报告期内，开发晶通过整合全球资源，将英特美荧光粉与普瑞封装产品相互结合，强化了LED照明品牌配套的价值链竞争力。未来开发晶将以市场需求为导向，通过LED外延及芯片技术整合，以高效能照明模块技术与制造和高性价比的委外制造模式，为公司未来发展提供新的增长点。

6) 产业基地概况

报告期内，公司在东莞独资设立封测产业基地，用于发展高性能存储芯片及满足未来新增产能持续扩张及存储芯片封测新技术发展的需求。公司持续推进海外走出去战略，在全球产业链核心地区进行产业布局，贴近大客户配套生产，在马来西亚、菲律宾等国家设有产业基地，在日本设有研发基地，在美国设有新产品导入基地。目前公司已建有深圳、苏州、东莞、惠州、成都、美国、马来西亚、菲律宾等产业基地。此外，在建的重庆智能制造基地占地约700亩，项目规划建设智能终端、无人机、电动汽车等电子产品的研发、生产和销售。在建的桂林智能制造基地占地约700亩，计划导入通讯和消费电子等智能制造服务业务。公司国内外产业基地的战略布局，为进一步开拓国内外市场奠定了坚实基础。

报告期内，深科技城已完成商业品牌落位，未来将建成以“科技、研发、金融、专业服务”为核心产业聚集的城市创新综合体，目前一期项目工程进展顺利，已完成工程桩的施工，2020年底前将完成北侧C栋及一期全部地下室的建设，南主楼A栋和中间B栋将于2021年底完成施工建设。深科技城项目在满足自用的前提下将以出租为主，届时将为公司带来更为充沛的现金流。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
硬盘及相关产品	4,360,830,735.90	4,048,957,621.99	7.15%	-3.05%	-5.36%	2.27%
自有产品	1,275,155,797.96	1,061,223,064.28	16.78%	9.13%	10.16%	-0.78%
OEM 产品	10,338,053,230.75	10,138,728,468.88	1.93%	21.58%	26.13%	-3.53%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”	第八届董事会第二十一次会议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,594,017,534.41 元，上期金额 1,662,029,392.52 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 1,709,497,335.08 元，上期金额 1,478,839,955.98 元；

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		调增“其他应收款”本期金额 84,219,006.69 元，上期金额 124,528,638.69 元； 调增“其他应付款”本期金额 12,214,580.13 元，上期金额 10,459,802.57 元； 调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第八届董事会第二十一次会议	调减“管理费用”本期金额 127,810,542.52 元，上期金额 80,246,770.10 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	第八届董事会第二十一次会议	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司因新设子公司而增加合并报表范围，分别为桂林深科技有限公司、东莞沛顿科技有限公司（深科技沛顿全资子公司）。

以上详见财务报告附注中的相关介绍。

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十日